

图书基本信息

书名：<<OrCAD&PADS高速电路板设计与仿真>>

13位ISBN编号：9787121036323

10位ISBN编号：7121036320

出版时间：2007-1

出版时间：电子工业

作者：周润景

页数：545

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书以OrCAD10.5与Mentor公司最新开发的Mentor Pads 2005.2版本为基础，以具体的电路为范例，讲解电路板设计的全过程。

原理图设计采用OrCAD10.5软件，讲解元器件原理图符号的创建、原理图设计；电路板设计采用PADS软件，详尽讲解元器件封装的建库，电路板的布局、布线；高速电路板设计采用Hyperlynx软件，进行布线前、后的仿真；输出采用CAM350软件，进行导出与校验等。

此外为了增加可操作性，网上提供本书的全部范例，使读者能尽快掌握该工具的使用并设计出高质量的电路板。

本书适合于对PCB设计有一定基础的中、高级读者，也可作为电子及相关专业PCB设计学习用书。

。

书籍目录

第1章 软件安装及License设置第2章 Capture原理图设计工作平台第3章 制作元器件及创建元器件库第4章 创建新设计第5章 PCB层预处理第6章 PADS Layout的属性设置第7章 定制PADS Layout环境第8章 PADS Layout的基本操作第9章 元器件类型及库管理第10章 布局第11章 布线第12章 覆铜及平面层分割第13章 自动标注尺寸第14章 工程修改模式操作第15章 设计验证第16章 定义CAM文件第17章 CAM输出和CAM Plus第18章 新建信号完整性原理图第19章 布线前仿真第20章 LineSim的串扰及差分信号仿真第21章 HyperLynx模型编辑器第22章 布线后仿真 (BoardSim) 第23章 BoardSim的串扰及GBit信号仿真第24章 多板仿真

编辑推荐

《OrCAD&PADS高速电路板设计与仿真》适合于对PCB设计有一定基础的中、高级读者，也可作为电子及相关专业PCB设计学习用书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>